

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2024-024

上海芯导电子科技股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯导科技”）于2024年8月26日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高性能分立功率器件开发和升级”“高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化”“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,500万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币134.81元，募集资金总额为人民币202,215.00万元，扣除发行费用人民币19,166.13万元后，募集资金净额为人民币183,048.87万元，其中超募资金金额138,672.87万元。前述募集资金已于2021年11月26日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年

11月26日对资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]44197号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2024年6月30日，公司募投项目及募集资金投入情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金 (万元)	累计投入募集资金 (万元)
1	高性能分立功率器件开发和升级	13,861.00	4,135.91
2	高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化	12,465.00	4,044.76
3	硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目	7,962.00	1,654.29
4	研发中心建设项目	10,088.00	3,215.1
合计		44,376.00	13,050.06

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

(一) 本次部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对下列募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前预定可使用状态 日期	调整后预定可使用状态 日期
1	高性能分立功率器件开发和升级	2024年下半年	2026年12月31日
2	高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化	2024年下半年	2026年12月31日
3	硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目	2024年下半年	2026年12月31日
4	研发中心建设项目	2024年下半年	2026年12月31日

(二) 本次募投项目延期的原因

公司前述募投项目的必要性及可行性已经充分论证。自首发募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施工作。但近年来，受地缘政治形势、全球经济环境、行业周期等宏观因素的不确定影响，公司的募投项目在实际推进过程中，对应产品的市场情况不及预期。具体而言，全球半导体行业依然处于低位，以智能手机为代表的消费电子领域整体表现低迷。据半导体产业协会

(SIA) 数据显示, 2023年全球半导体产业销售总额为5,268亿美元, 比2022年下降8.2%。公司结合募投项目对应市场的实际需求情况, 秉承合理有效使用募集资金的原则, 在募投项目的推进上更加谨慎、严谨、科学, 整体进度较原计划适当放缓, 以有效控制成本、降低风险、提高资产流动性。

结合公司的发展战略, 及募投项目的实施进度, 公司经审慎研究, 决定将“高性能分立功率器件开发和升级”“高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化”“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”“研发中心建设项目”达到预计可使用状态延期至2026年12月31日。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定, 未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体, 不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 不会对公司的正常经营产生重大不利影响, 符合公司长期发展规划, 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、审议程序及专项意见说明

(一) 董事会的审议情况

公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于募投项目延期的议案》, 同意公司将募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“高性能分立功率器件开发和升级”“高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化”“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期, 该事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

经审议, 监事会认为: 公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 不会对公司的正常经营产生重大不利影响, 符合公司长期发展规划, 决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

因此，公司监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2024年8月28日